

国泰君安证券股份有限公司

关于锦州神工半导体股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“神工股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1、2020 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]100号）核准，公司采用战略配售、网上网下方式发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股21.67元，募集资金总额866,800,000.00元，扣除承销费、保荐费76,049,433.93元后的790,750,566.07元已于2020年2月17日分别存入公司在中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行0708004329200067771账户300,000,000.00元，存入在锦州银行股份有限公司金凌支行410100692121518账户300,000,000.00元，存入在锦州农村商业银行股份有限公司营业部392212010160740453账户190,750,566.07元；减除审计费、律师费、信息披露等发行费用15,881,132.08元后，实际募集资金净额为人民币774,869,433.99元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊

普通合伙)验证,并出具了大信验字[2020]第1-00010文号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2023年向特定对象发行股票

公司于2023年9月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许[2023]2051号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票10,305,736股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为29.11元,募集资金总额为人民币299,999,974.96元,扣除不含税的发行费用人民币3,943,396.22元后,实际募集资金净额为人民币296,056,578.74元。上述资金已全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述募集资金到位情况进行了审验,并于2023年9月15日出具了《验资报告》(容诚验字[2023]110Z0012号)。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二) 募集资金使用及结余情况

1、2020年首次公开发行股票

截至2023年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金净额	774,869,433.99
减:期初累计已使用募集资金的金额	614,991,499.58
减:本期已使用募集资金的金额	112,203,160.65
减:募集资金结余利息补充流动资金的金额	1,654,855.96
加:募集资金专项账户银行利息收入	49,492,652.71
募集资金专户余额	95,512,570.51

2、2023年向特定对象发行股票

截至2023年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金净额	296,056,578.74

项目	金额
减：期初累计已使用募集资金的金额	-
减：本期已使用募集资金的金额	25,828,343.68
减：募集资金结余利息补充流动资金的金额	-
加：募集资金专项账户银行利息收入	164,464.73
募集资金专户余额	270,392,699.79

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《锦州神工半导体股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

2020年2月，中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行、锦州银行股份有限公司金凌支行、锦州农村商业银行股份有限公司营业部、国泰君安、公司签订募集资金专户存储三方监管协议。监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。

2023年9月，公司、国泰君安证券股份有限公司与招商银行锦州分行营业部、中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020年首次公开发行股票

截至2023年12月31日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：元

开户主体	开户银行	银行账号	余额
公司	中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行	0708004329200067771	95,510,206.85
公司	锦州银行股份有限公司金陵支行	410100692121518	2,363.66
公司	锦州农村商业银行股份有限公司营业部	392212010160740453	已注销，零余额
合计			95,512,570.51

2、2023 年向特定对象发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：元

开户主体	开户银行	银行账号	余额
公司	招商银行锦州分行营业部	416900037710703	205,483,390.85
公司	中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行	0708004329200669624	64,909,308.94
合计			270,392,699.79

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募投项目的资金使用情况详见“附表 1：2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”与“附表 2：2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2020 年首次公开发行股票

报告期内，公司不存在先期投入及置换情况。

2、2023 年向特定对象发行股票

公司于 2023 年 10 月 27 日召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,337,697.02 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中以自筹资金预先投入

募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 2,818,829.10 元，以自筹资金支付发行费用金额为人民币 518,867.92 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于锦州神工半导体股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]110Z0157 号）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 3 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币 18,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 6 个月。

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币 15,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 6 个月。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币 20,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现

金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

1、2020 年首次公开发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：元

银行名称	产品名称	金额	起止期限	预计年化收益率	是否赎回
中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行	通知存款	85,000,000.00	2023-8-29 至无固定期限	1.75%	否

2、2023 年向特定对象发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：元

银行名称	产品名称	金额	起止期限	预计年化收益率	是否赎回
招商银行锦州分行营业部	定期存款	50,000,000.00	2023-12-20 至 2024-3-20	1.80%	否
招商银行锦州分行营业部	定期存款	50,000,000.00	2023-12-20 至 2024-6-20	2.00%	否
招商银行锦州分行营业部	通知存款	99,000,000.00	2023-12-20 至无固定期限	1.55%	否

（六）结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

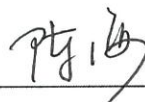
（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于锦州神工半导体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人签字：



姚巍巍



陈海

国泰君安证券股份有限公司

2024年3月29日



附表 1：2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				77,486.94		本年度投入募集资金总额				11,220.32		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				72,719.47		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目 (含部分变更, 如有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)=(2)-(1)	截至 期末 投入 进度 (%)(4) = (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
1、研发中心 建设项目	否	23,276.81	17,486.94	17,486.94	-	17,505.88	18.94	100.11	2022 年 2 月	不适 用	不适 用	否
2、8 英寸半导 体级硅单晶 抛光片生产 建设项目	否	86,923.41	60,000.00	60,000.00	11,220.32	55,213.59	-4,786.41	92.02	2024 年 2 月	不适 用	不适 用	否
合计	-	110,200.22	77,486.94	77,486.94	11,220.32	72,719.47	-4,767.47	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见“三、2023 年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见“三、2023年度募集资金的实际使用情况”之“(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况
募集资金其他使用情况	不适用

附表 2：2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				29,605.66		本年度投入募集资金总额				2,582.84		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				2,582.84		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目 (含部分变更, 如有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)=(2)-(1)	截至 期末 投入 进度 (%)(4) = (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
1、集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目	否	21,000.00	20,905.66	20,905.66	369.10	369.10	-20,536.56	1.77	2025年10月	不适用	不适用	否
2、补充流动资金	否	9,000.00	8,700.00	8,700.00	2,213.74	2,213.74	-6,486.26	25.45	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	30,000.00	29,605.66	29,605.66	2,582.84	2,582.84	-27,022.82	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见“三、2023年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见“三、2023年度募集资金的实际使用情况”之“(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况
募集资金其他使用情况	不适用